

0528强势股脱水 | 受益“韬”定律的几个产业链细分

2026/05/28 17:32

“

- ①超节点：国产GPU单卡算力弱于英伟达，但通过超节点将数百张卡高速互联，可在集群层面比肩甚至超越海外方案。Scale Up交换芯片是核心增量，国产超节点中交换芯片与GPU配比显著高于海外，预计2028年国产Scale Up交换芯片市场达129亿元，26-28年复合增长率212%。超节点协议标准尚未统一，国产芯片厂商与海外巨头处于同一起跑线，本土化适配优势有望加速市场份额提升。
- ②半导体：全球8英寸产能利用率已回升至近90%，台积电规划减产12英寸成熟制程，转单效应向国内晶圆厂溢出，涨价氛围持续升温。国内先进制程需求到2030年预计达约10万WPM，而国内规划产能约7-8万，供不应求态势有望持续。
- ③散热：芯片功耗从H100的700W跃升至GB300的1400W，超节点机柜功耗超出风冷散热上限，液冷从可选走向必选。冷板式液冷占液冷市场80%-90%份额。金刚石铜导热系数突破1000W/(m·K)，2026年4月在国内超算节点首次规模化部署，预计2030年该材料在AI芯片散热领域市场规模达480-900亿元。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

1、超节点：万众期待

(1) 大涨题材： 华为产业链+东数西算+交换机+光通信

"互联"是A股人工智能产业链中的核心，包括光通信、铜缆、交换机等多个产业。

根据华为和DeepSeek披露，华为Atlas 950超节点计划于下半年上市，支持8192张昇腾卡高速互联。超节点是通过高速互联协议与专用交换芯片构建的高带宽域，将数十至数百颗GPU芯片在逻辑上整合为统一编址、低延迟、高带宽的协同计算系统。该架构保留GPU的物理独立性，通过统一虚拟内存地址空间与无损互联，实现类单机的编程与调度体验。且超节点并非GPU的简单物理堆砌，而是融合多芯片、整机硬件、高速互联与配套软件的集成系统。

在近期韬定律刷屏背景下，超节点也开始被关注，服务器中兴通讯等涨停，交换芯片盛科通信等大涨。

股票名称	最新价	涨跌幅
中京电子 002579.SZ 公司部分 PCB 产品已配套智邦、锐捷网络、技嘉等客户用于交换机，珠海富山新工厂将交换机作为高端 PCB 重点应用方向，所产高多层板等产品具备高频高速等技术特点，可满足交换机领域的相关应用需求	18.19	3 连板 +9.98% 13:27 涨停
中兴通讯 000063.SZ 白马 公司推出了 ZXR10 5960XM、ZXR10 9916 等涵盖数据中心、园区等场景的多款交换机产品，还含自研 RDMA 交换机，相关产品适配智算、云等多业务场景且多次中标运营商采购项目	38.30	首板 +9.99% 13:45 涨停
盛科通信 688702.SS 拟减持 公司是国内领先的以太网交换芯片设计企业，自主研发覆盖接入层至核心层的以太网交换芯片，还基于自研芯片开发白盒交换机，其交换芯片也已进入新华三、锐捷网络等主流网络设备厂商供应链，适配各类交换机相关产品及多领域网络场景	303.81	+7.83%
剑桥科技 603083.SS 拟减持 公司生产以太网交换机等产品，涵盖企业级、运营商级和数据中心级交换机，还在推进 CPO 相关技术研发以实现光模块与交换机的互联互通，其交换机产品能为不同规模企业和服务商提供高性能网络解决方案并简化配置管理	203.04	+7.71%
中威电子 300270.SZ 扭亏 公司专注工业互联硬件设备研发，推出了工业以太网交换机、全国产工业以太网交换机等多款交换机产品，且相关产品适用于城市交通、智能电网等多个行业场景	13.64	+7.66%
工业富联 601138.SS 白马·连阳·绩优 公司 800G 交换机全球市占率超 75%，1.6T 交换机已与多家客户联合开发并取得在手订单，还完成了下一代 Vera Rubin NVL144 平台交换机开发，同时其交换机产品适配英伟达等巨头相关系统且配套液冷、CPO 等技术	75.00	+7.02%
杰华特 688141.SS 公司大电流多相电源、DC-DC、热插拔控制器等多款产品可应用于交换机，且推出的 12 相多相控制器 JWH6377 等多相供电方案还适配交换机的大电流供电场景，能为交换机等通信产品提供一站式模拟芯片解决方案	103.50	+5.89%

(2) 研报深度复盘（财通证券、华泰证券、东方证券、国泰海通）：重塑算力网络格局

①超节点的本质，是用通信能力弥补单芯算力的差距。面对国产GPU单卡算力仍落后于英伟达的现实，华为CM384超节点以英伟达GB200 NVL72约5倍的卡数，实现了约1.7倍的算力性能，验证了"用Scale Up网络补算力"的可行性。这一逻辑正在被阿里、曙光、百度等厂商广泛复制，2026年或将成为国产超节点密集出货的元年。

②华为"韬（τ）定律"为超节点提供了更深层的理论支撑。韬定律以"时间缩微"取代"几何缩微"，将性能优化路径从缩小晶体管转向压缩信号时延，直接指向互连、布线和数据搬运瓶颈。在AI系统端，统一总线将远程访问时延从数十微秒压至150纳秒以下，近封装光学Hi-ONE将单模块带宽提升至8Tbps。这一理论不仅是华为产品路线的系统阐释，也为国产协议与生态构建提供了底层依据，麒麟2026将首次应用逻辑折叠，晶体管密度较上一代提升53.5%，验证了该路径的实际落地效果。

③Scale Up交换芯片是超节点方案中最核心的增量环节。相比传统8卡服务器组网，超节点机柜内GPU数量大幅增加，且GPU之间互联带宽更高、延迟更低，使得Scale Up网络对交换芯片的需求远高于Scale Out。以华为CM384单节点为例，交换芯片与NPU的配比达7:8，远高于英伟达H100集群的约5%配比。基于国内外算力差距，国产超节点中交换芯片与GPU的配比或系统性高于海外方案，是一个被市场低估的量级差异。

市场空间测算显示出加速增长的态势。预计到2028年，国内Scale Out交换芯片市场规模可达174亿元，26-28年复合增长率34%；Scale Up交换芯片市场规模有望达172亿元，26-28年复合增长率高达231%。

④国产交换芯片厂商在Scale Up赛道或更具优势。Scale Up互联协议目前全球尚未形成统一标准，国产厂商与博通等海外巨头实际上处于同一起跑线。超节点的复杂性要求交换芯片与

GPU进行深度底层适配，本土厂商在架构开放和现场调试上更具配合意愿。此外，盛科通信参与中国移动OISA 2.0协议、中兴通讯发布“凌云”芯片已构建Nebula星云超节点，均表明国产厂商正快速切入这一新兴赛道。

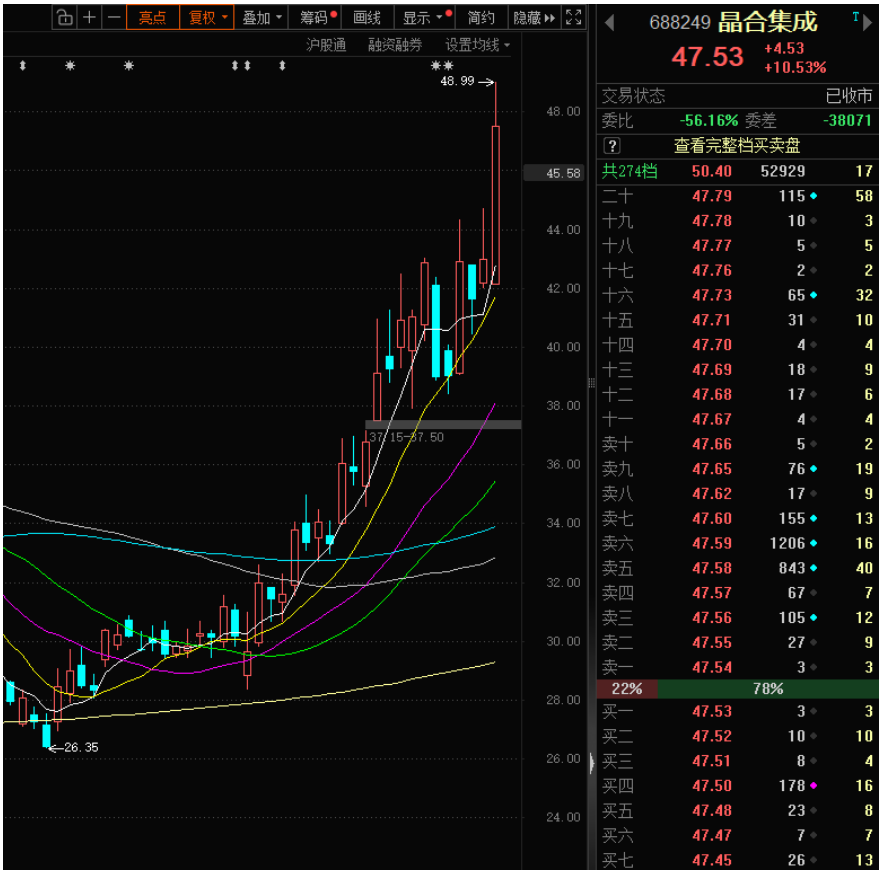
2、晶圆代工：半导体核心

(1) 大涨题材：半导体

媒体报道，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。芯片制造商联电今日召开股东常会也表示，今年下半年展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

行业研究机构称，全球8英寸产能利用率已由2025年的近80%回升至近90%，12英寸成熟制程亦因台积电规划减产有望带动转单，涨价氛围逐渐浮现。国内来看，包括逻辑、存储在内的晶圆产能供给紧俏，晶圆厂潜在扩产空间可观。

行情上，华虹公司、晶合集成等晶圆公司今日大涨。



(2) 研报深度复盘（华兴证券、中信建投、东北证券）：成熟制程涨价，国产晶圆厂量价双升

①晶圆代工是集成电路产业的核心制造环节，负责将芯片设计转化为可量产的实体产品，处于整个半导体产业链的中游枢纽位置。行业具有资本密集、技术壁垒高、客户粘性强的典型特征，属于政策驱动与长周期成长并存的行业属性。

先进制程主要服务于AI算力芯片、高性能计算及旗舰移动平台等高附加值场景；成熟制程则广泛覆盖电源管理、工业控制、汽车电子、物联网等领域，应用场景高度分散、需求相对稳定。当前行业正经历从传统消费电子向AI、数据中心等高附加值领域的需求结构迁移。

②国内先进制程呈现供不应求态势，且有望持续至2030年。综合测算，国内AI相关先进制程需求到2030年或达约10万WPM（片/月），而国内厂商规划月产能届时预计在7-8万WPM，

整体呈现供不应求状态。美国出口管制持续收紧的背景下，AI HPC、汽车ADAS、人形机器人等客户加速向国内先进制程转移。

③除了中心、华虹等龙头，晶合集成等公司逻辑在于从"DDIC专属代工"向多元工艺平台的结构性跃迁。

目前公司在DDIC领域以23.3%市占率稳居全球第一，而28nm逻辑工艺平台已完成开发，OLED驱动产品持续验证中，四期工厂预计2026年四季度设备进场。CIS方面，与思特威签署长期战略合作协议，目标从第一阶段1.5万片/月逐步提升至4.5万片/月。

逻辑芯片方面，公司联合汇成股份投资鑫丰科技，有望在四期工厂落成后与长鑫存储建立紧密代工合作，深度受益于AI驱动的存储需求爆发。与此同时，公司向客户发出涨价函，**所有产品自2026年6月1日起涨价10%**，价格弹性将直接反映至毛利率改善。

3、散热：不得不跟着突破

(1) 大涨题材：液冷+金刚石

在"稻定律"发布后，靠堆叠换性能的路线让散热问题成为焦点之一。

华为此前已前瞻布局"微泵液冷+风扇"主动式散热方案，且华为昇腾950PR处理器功耗已经达到600W。考虑到折叠技术的应用，后续未发布的芯片功耗持续上涨可能性较高。

分析认为，服务器端算力与网络向更高频率、更大带宽演进，叠加集群化与超节点化，液冷或成为释放有效算力与能效的必要条件。行情上，雪人集团、飞荣达大涨，此外，另一大散热细分金刚石材料也连续强势。

飞荣达 300602.SZ		
液冷服务器散热解决方案核心供应商，产品覆盖冷板、液冷模组、导热界面材料等全链条，已进入华为、浪潮、腾讯等头部客户供应链，为多款旗舰液冷服务器提供配套，依托自身导热材料与结构件整合能力，提供“材料+结构”一体化液冷散热服务	49.08	+9.48%
中鼎股份 000887.SZ		
公司子公司中鼎流体及中鼎智能热系统主导热管理系统总成业务的发展，积极布局热管理系统总成及核心零部件产品的研发与生产，拥有自主知识产权；目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品	21.28	+8.13%
新莱应材 300260.SZ 密集调研		
全资子公司江苏慕康普廷精密科技有限公司，现阶段研发的CDU（冷量分配单元）产品主要应用于液冷服务器的数据中心液冷系统	61.21	+7.27%
光迅科技 002281.SZ		
公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品	214.90	+6.02%
硕贝德 300322.SZ		
公司液冷散热产品可应用于服务器、路由器、交换机等领域；液冷板采用微通道一体成型工艺，导热效率优异，适配英伟达H100、AMD MI300等主流AI芯片散热需求，散热液冷板已向客户批量出货	35.05	+5.73%
光弘科技 300735.SZ		
公司自2025年起开展算力服务器相关业务，已收获国内大客户液冷服务器算力板卡、算力单元订单	24.74	+5.73%
鼎通科技 688668.SS 连阳		
公司的液冷产品主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，服务器和数据中心均可以适用，液冷产品主要客户为安费诺、莫仕、泰科、立讯精密等	303.75	+5.65%
澄天伟业 300689.SZ 转亏		
公司专注于液冷产品领域，已建立液冷产品核心制造和验证体系，具备从结构设计、材料选型到系统集成的技术能力；公司液冷业务聚焦AI服务器、高性能计算等场景	58.49	+5.56%

(2) 研报深度复盘（华源证券、华福证券、东北证券）：从可选走向必选

①功耗天花板的打破，正在将散热从"配套环节"推向"算力释放的先决条件"。英伟达GB300 TDP达1400W，华为昇腾950PR已达600W，下一代Rubin架构芯片最大功耗预计突破2000W。**风冷的经济散热上限约为40-60kW/机柜，而英伟达NVL72机柜功耗已达120kW，华为Atlas 900超算柜功耗达54kW**，超出风冷有效散热区间。液冷不再是选配，而是算力能否稳定释放的物理前提。

②据预测，全球服务器液冷市场规模将从2026年126亿美元增长至2030年535亿美元，2026-2030年复合增速44%，其中冷板市场有望达230亿美元（折合人民币超千亿）。中性情景下测算，**2030年AI芯片领域金刚石散热市场规模有望达480-900亿元**，是当前较为稀缺的高成长性细分赛道。

③金刚石铜复合材料代表下一代散热材料的升级方向。传统导热材料热导率已逼近极限，金刚石铜兼具金刚石超过2000W/(m·K)的导热系数与铜的成型优势，通过3D打印工艺制备的微通道液冷板，导热系数突破1000W/(m·K)，界面热阻降低至0.1K/W，可适配1500W/cm²以上的超高热流密度场景。英伟达已宣布下一代Vera Rubin架构将全面采用金刚石铜+液冷方案，2026年或成为金刚石铜规模化应用的元年。

④华为在终端侧的主动散热布局已率先落地，验证了这一技术路线的商业可行性。Mate 80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，采用仿生羽翼涡扇与超导热弯流翅片设计，散热效率显著提升；飞荣达自研微泵液冷方案已获头部客户认证，艾为电子的压电微泵液冷驱动方案具备低功耗、小体积优势，可适配高算力手机、PC、AI眼镜等终端。**算力与网络向更高频率演进，叠加超节点化趋势，液冷或成为压缩系统时延常数τ、释放有效算力的必要条件**，散热行业的成长逻辑从周期性需求转向结构性刚需。

研报来源：

财通证券，唐佳，S0160525110002，超节点专题报告一：国产超节点落地提速，供应链环节弹性可期，2026年4月23日。

华泰证券，王兴，S0570523070003，交换芯片：AI超节点驱动二次成长，2026年5月22日。

东方证券，薛宏伟，S0860524110001，电子行业动态跟踪：Agent推理时代，交换芯片持续通胀，2026年5月28日。

国泰海通证券，杨林，S0880525040027，华为"韬"定律重新定义芯片优化规则："韬"定律开辟新路径，国产算力景气上行，2026年5月27日。

华源证券，李宏涛，S1350526030001，韬（τ）定律："时间缩微"压缩信号时延，提升国产算力跃升效率，2026年5月26日。

中信建投，刘双锋，S1440520070002，周报：晶圆代工成熟制程有望涨价，英伟达与康宁达成战略合作，2026年5月10日。

华兴证券，王国喆，S1680524080001，先进制程供给不足，成熟制程有望迎来更多整合，2026年5月20日。

东北证券，李玖，S0550522030001，布局高阶工艺，晶圆代工新锐迎来星辰大海，2026年5月6日。

申万宏源，刘洋，A0230513050006，华为"韬（τ）定律"的短期、中期与长期！，2026年5月26日。

东北证券，李玖，S0550522030001，华为用3D堆叠换性能，功耗大幅提升利好主动散热，2026年5月27日。

华福证券，孟鹏飞，S0210526040001，3D打印微通道冷板：下一代高热流密度液冷的关键解法，2026年5月19日。

***免责声明：**文章内容仅供参考，不构成投资建议

***风险提示：**股市有风险，入市需谨慎

本资讯中的内容来自持牌证券机构，意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。亦不应以本资讯取代自己的判断。

本文内容和观点不代表选股通APP平台观点，请独立判断和决策。在任何情况下，选股通APP不对任何人因使用本平台中的内容所引致的任何损失负任何责任。